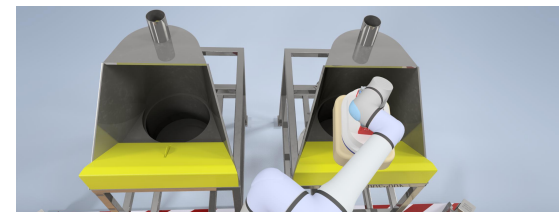
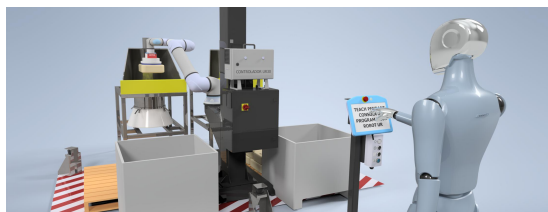


# OA25004 (2) v1.0

Presentación Técnica

PI\_007

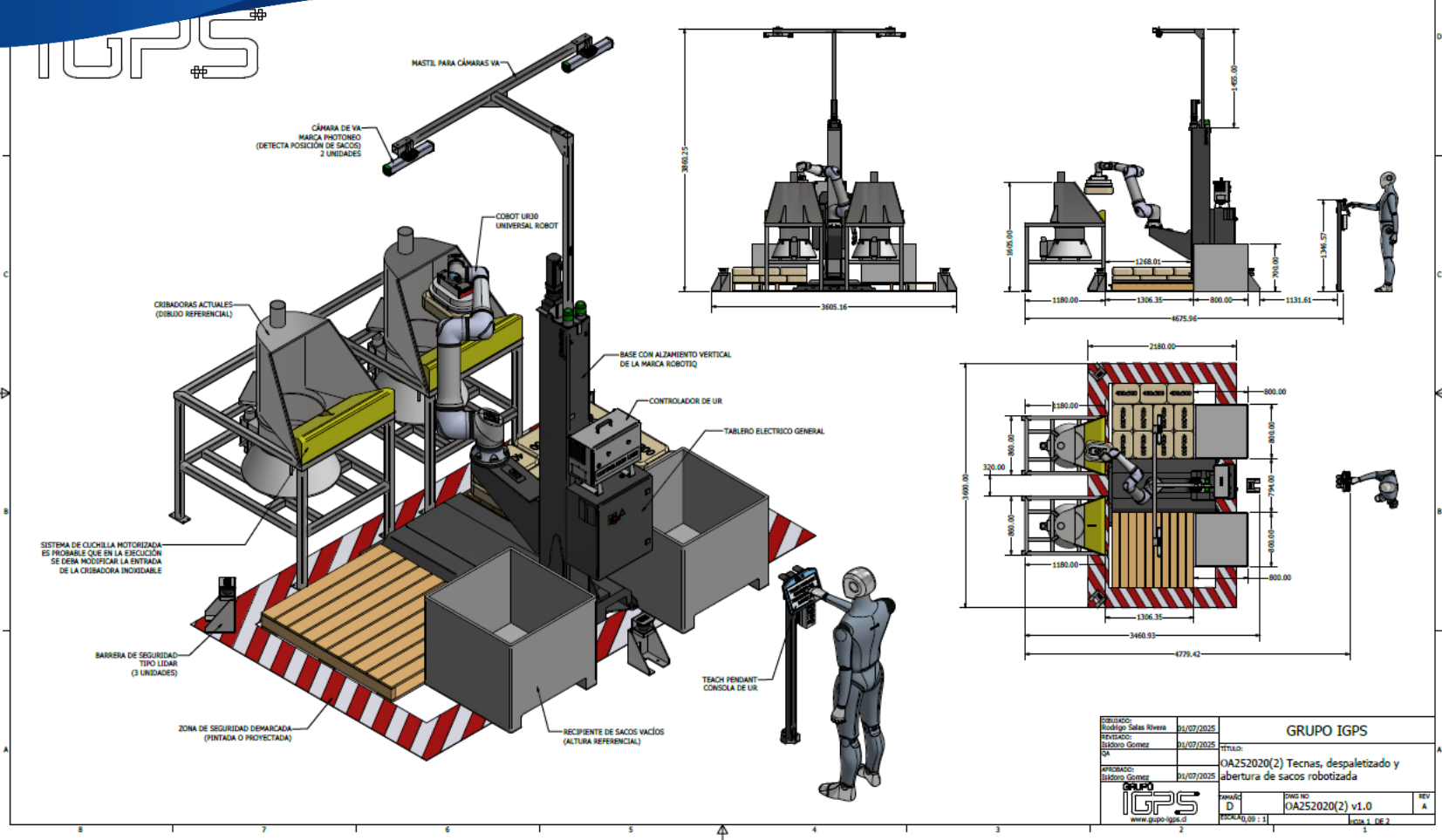
Célula Despaletizado y Vaciado Sacos UR30



# Solución Técnica

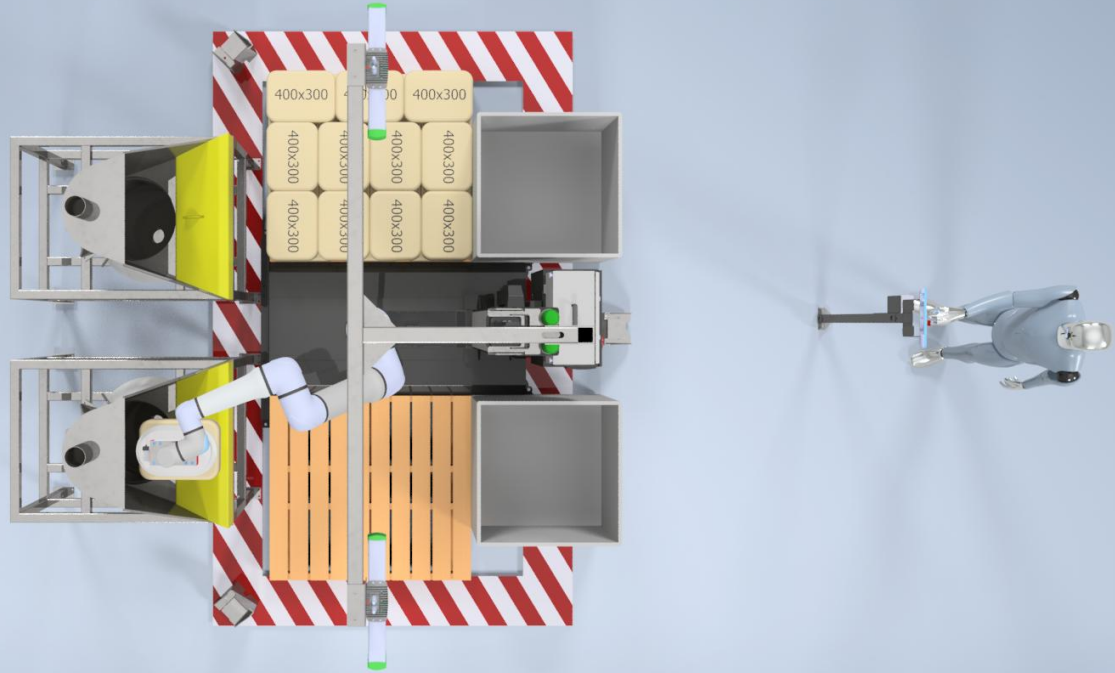


# Implantación

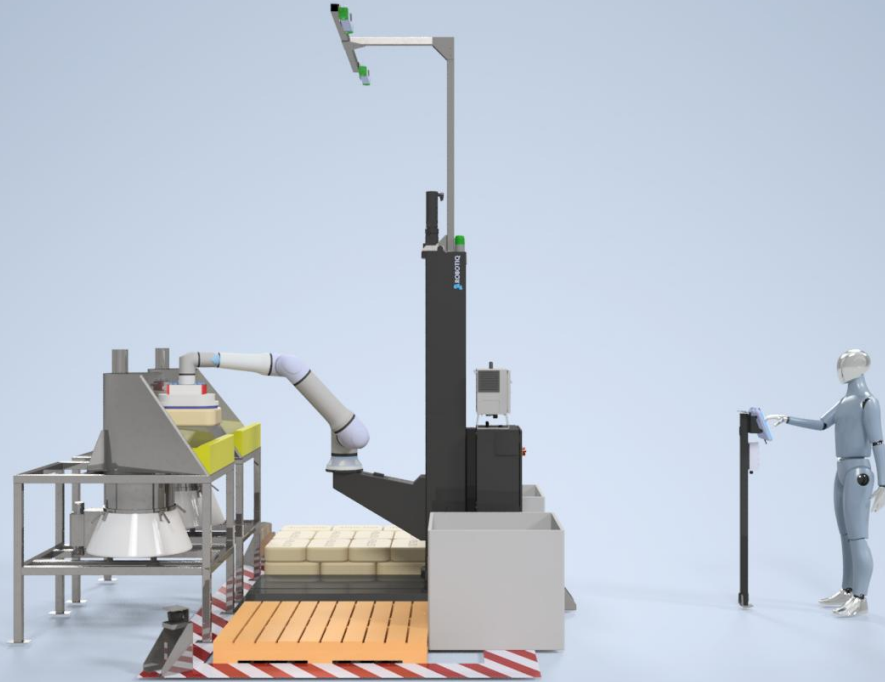


DISEÑADO: Rodrigo Salas Rivera		31/07/2025	<b>GRUPO IGPS</b>
REVISADO: Salvador Gomez		31/07/2025	
DISEÑADO: Salvador Gomez		31/07/2025	TITULO: OA25202(2) Tecnas, despaltizado y abertura de sacos robotizada
PROYECTO: D		FECHA: 31/07/2025	ESCALA: 1:1
PROYECTO: OA25202(2) v1.0		HOJA: 1 DE 2	REV: A

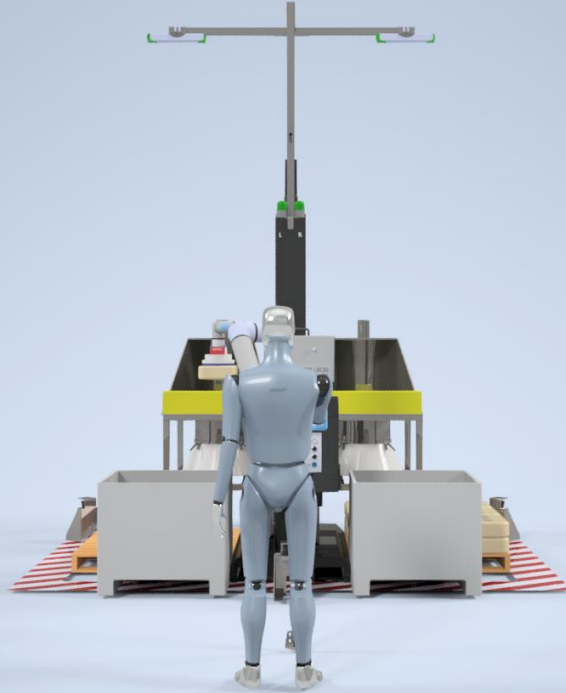
# Implantación



# Implantación



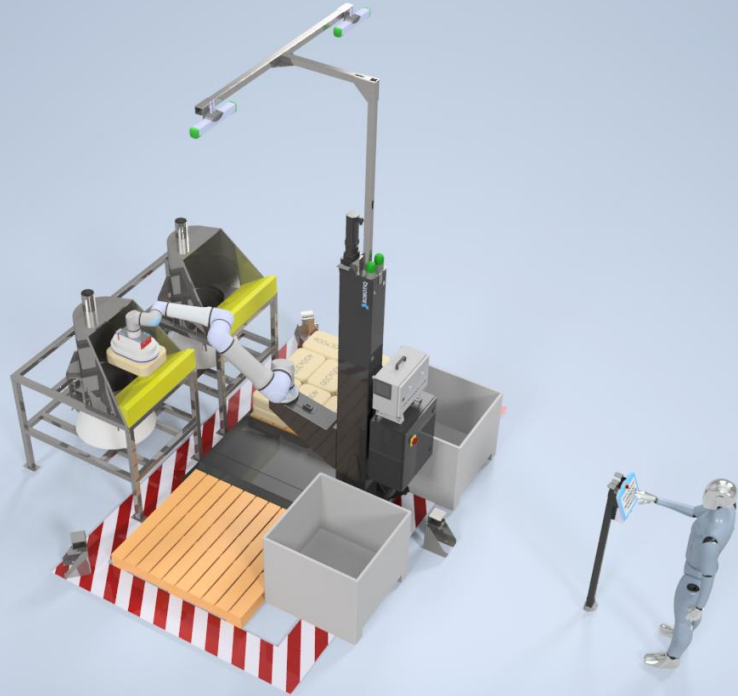
# Implantación



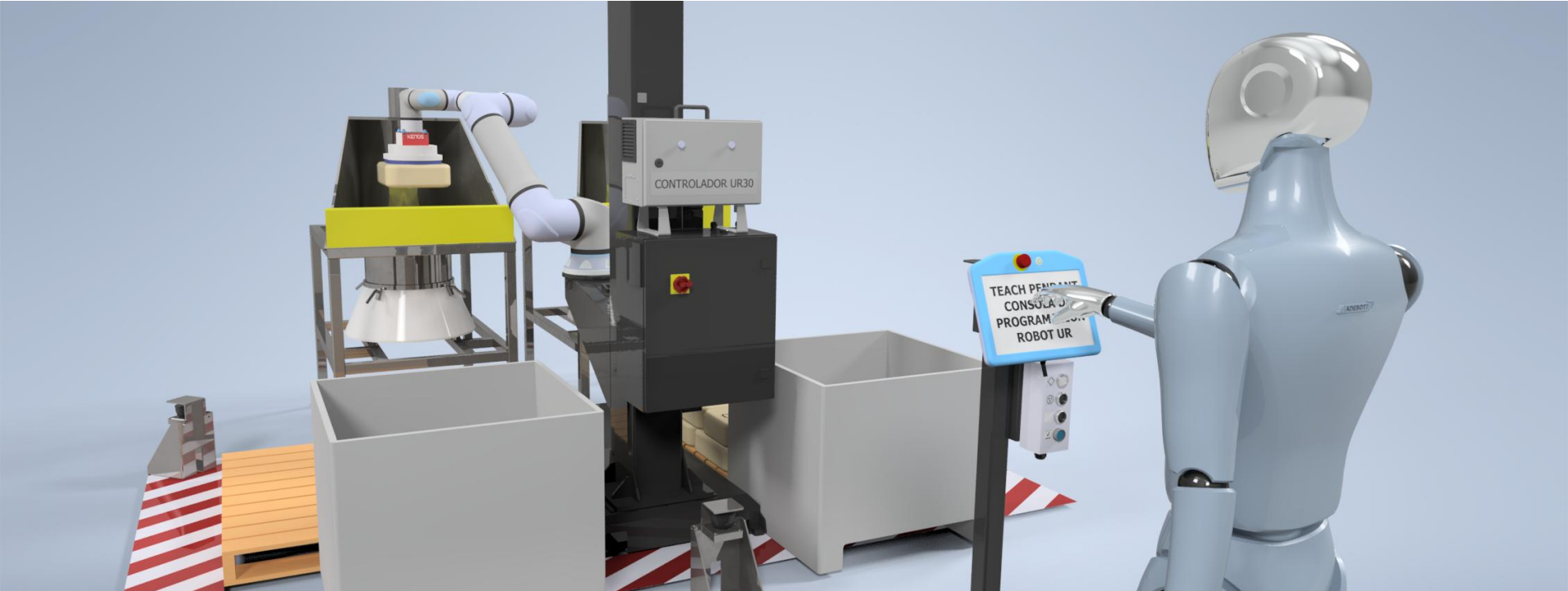
# Implantación



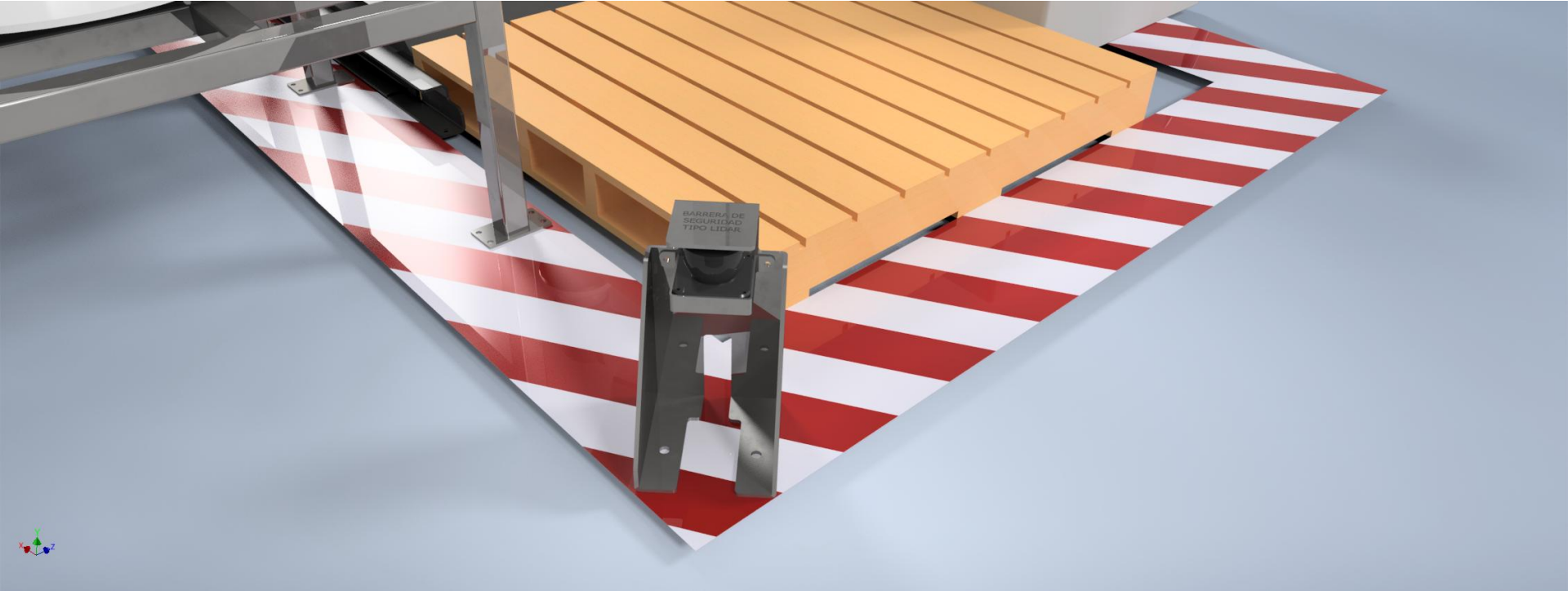
# Implantación



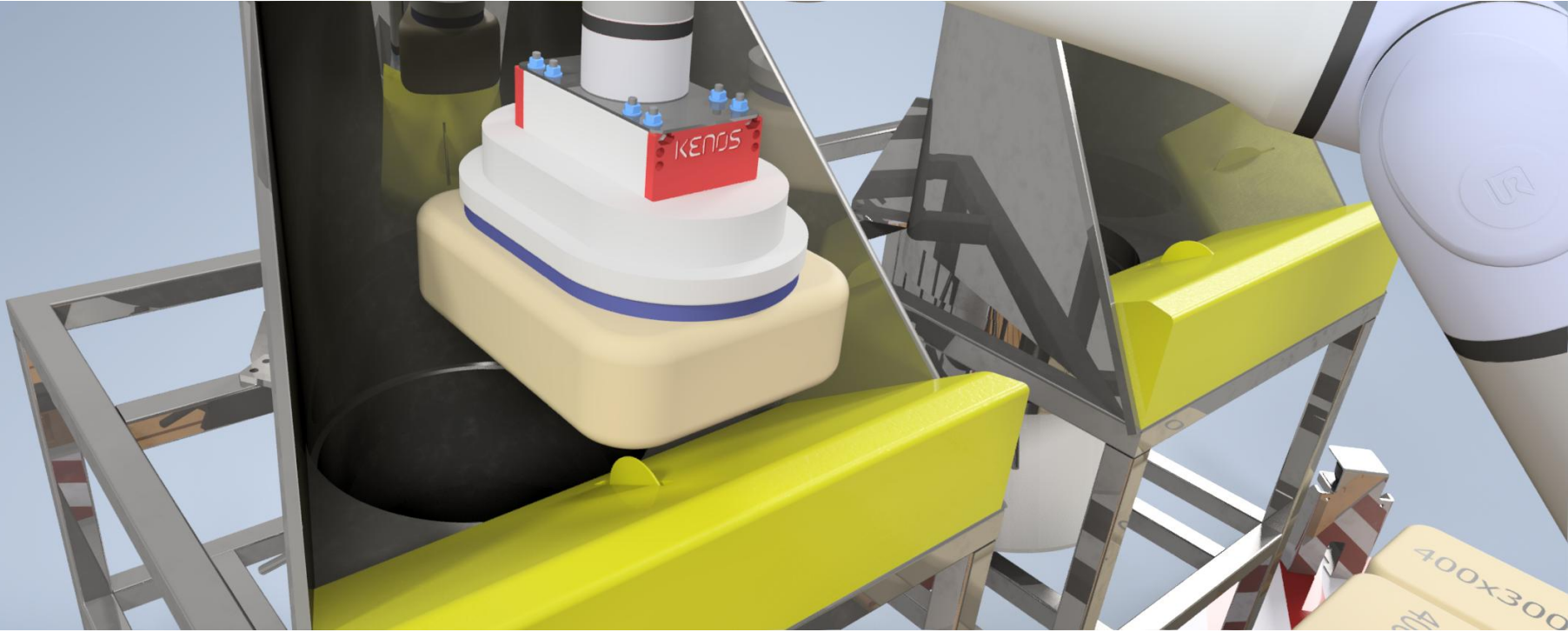
# Implantación



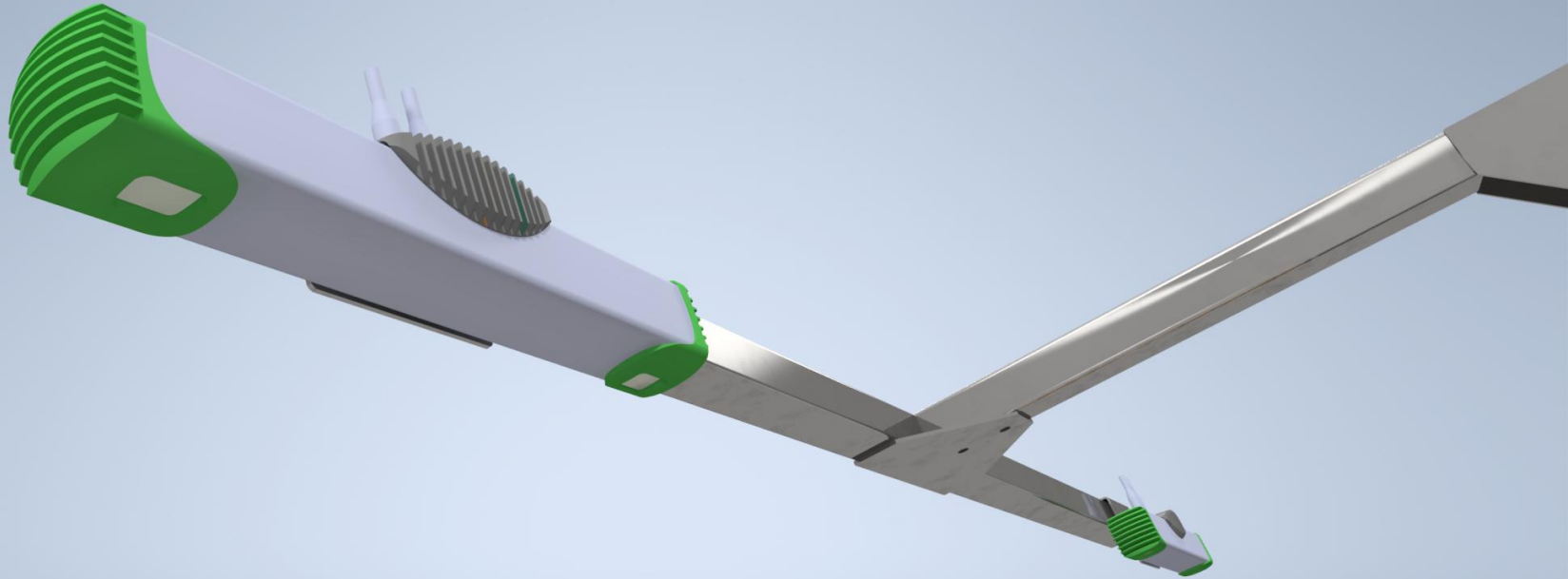
# Implantación



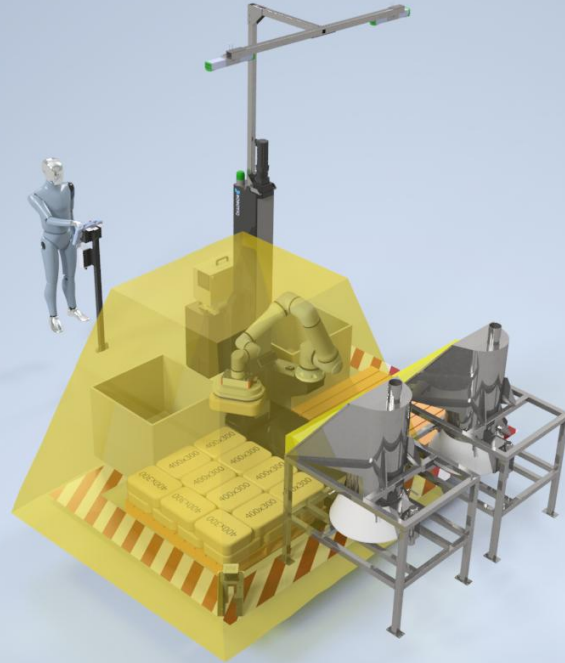
# Implantación



# Implantación



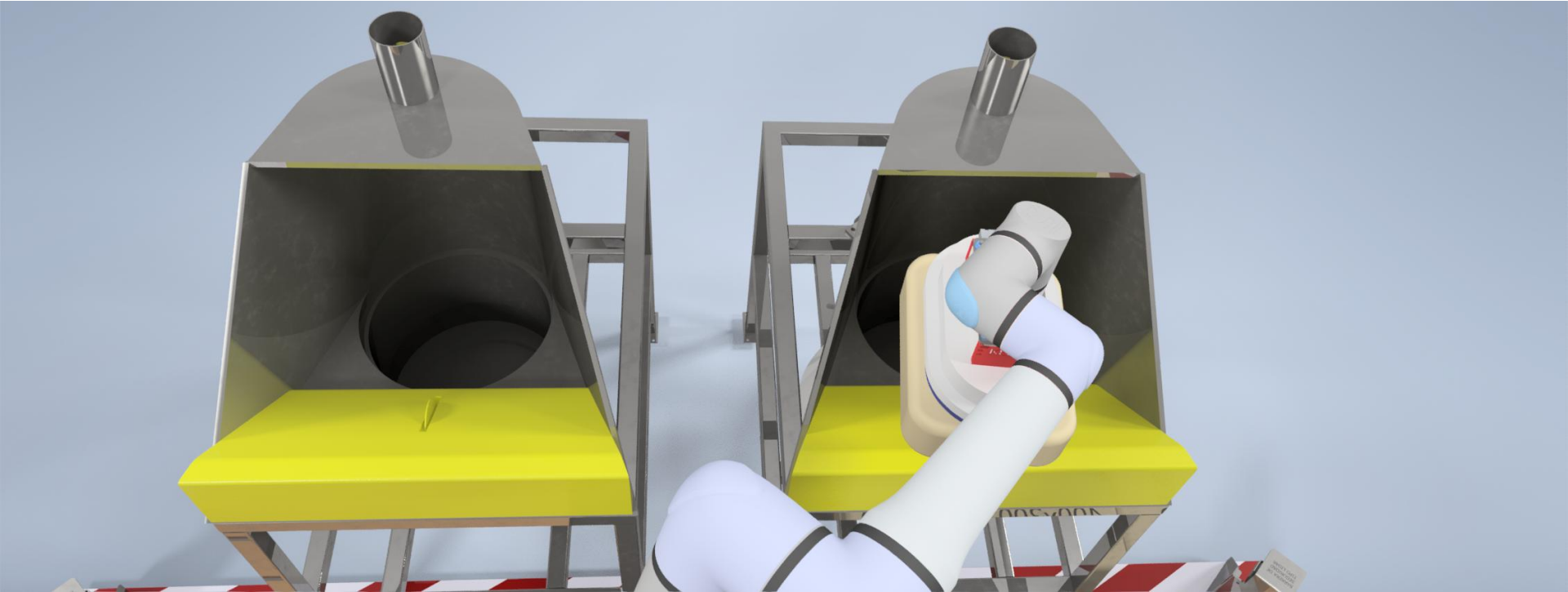
# Implantación



# Implantación



# Implantación



# Gripper Cobot de Vacío

---


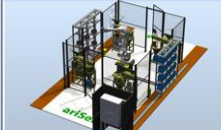

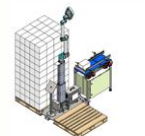





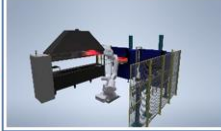











## Kenos<sup>®</sup>KSG



- El KSG (Kenos Sack Gripper) puede equiparse con eyectores COAX<sup>®</sup> o conector para generación de vacío externa.
- El KSG está diseñado y es capaz de manipular sacos pesados en diferentes materiales, formas y pesos.
- Con opciones de sellado por espuma o por anillo metálico para una larga duración.
- Cartucho COAX<sup>®</sup> de tres etapas - MIDI- con un caudal de vacío extra inicial. Caudal de vacío elevado en relación con el consumo energético. Lo último en tecnología de eyección dentro.

Contacto



<b>Seguridad de Máquinas Robótica Colaborativa</b> 	<b>Robotizaciones Especiales</b> 	<b>Distribuciones Ind 4.0 Simulación   Soporte</b> 	<b>Final de Línea Paletizado</b> 	<b>Enejado Estuchado</b> 			
							
	<b>Vallados Seguridad Automatización y Robótica   Logística</b> 						
<b>Escaneado BIN CIM Ingeniería Inversa Metrología 3D Fotogrametría</b> 							



**Isidoro Gómez**  
CRO  
✉ [isidoro.gomez@igps.es](mailto:isidoro.gomez@igps.es)  
☎ +56 9 3197 5128

Apoquindo 5950. Piso 18. Oficina 18-110.  
Las Condes. Santiago RM. CHILE  
[www.grupo-igps.cl](http://www.grupo-igps.cl)



**Oscar Sandoval**  
Commercial manager LATAM  
✉ [osandoval@igps.es](mailto:osandoval@igps.es)  
☎ + 57 3218780665

Apoquindo 5950. Piso 18. Oficina 18-110  
Las Condes. Santiago RM. CHILE  
[www.grupo-igps.cl](http://www.grupo-igps.cl)

**Oficina Comercial:** Apoquindo 5950, Piso 18,  
Oficina 18-110 | Las Condes | Santiago | CHILE  
**Email:** [isidoro.gomez@igps.es](mailto:isidoro.gomez@igps.es) |  
[igomez@arisens.cl](mailto:igomez@arisens.cl)

**Email:** [osandoval@igps.es](mailto:osandoval@igps.es)  
**Web:** [www.grupo-igps.cl](http://www.grupo-igps.cl)

**Cel:** +56 9 3197 5128  
**Cel:** +57 3218780665

Empresas:

Representaciones / Alianzas Estratégicas:

